

(0,635mm) .025"

QSS 系列



QSS-050-01-F-D-A

QSS-075-01-F-D-A

QSS-025-01-L-D-A

高速接地插座

技术规格

如需了解完整技术规格以及所建议的 PCB 布局, 请浏览 www.samtec.com?QSS

绝缘体材料:

液晶聚合物

触点材料:

磷青铜

电镀:

在 50μ" (1,27μm) 的镍上

镀金或锡

额定电流:

触点: 30°C 温升时为 1.1A

接地板: 30°C 温升时为 7.8A

工作温度:

-55°C 至 +125°C

额定电压:

285 VAC

最大配接次数:

100

符合 RoHS 规范要求:

是

加工:

可无铅焊接:

是

SMT 引线共面性:

(0,10mm) .004" 最大 (025-050)

(0,15mm) .006" 最大 (75-100)

电路板叠叠:

有关每块电路板需要两个连接器

或 100 个位置或更多位置的应用, 请联系 ipg@samtec.com

FILE NO. E111594

电路板配接:

QTS

线缆配接:

SQCD



ELP
EXTENDED LIFE PRODUCT

50μ" 镀金的 10 年腐蚀和老化试验
有关与 QTS 配接的最大插拔次数, 请致电 Samtec

5mm 堆叠高度	类型	在 3dB 插入损耗的额定值
单端信号	-D	9 GHz / 18 Gbps
差分对信号	-D	8.5 GHz / 17 Gbps
差分对信号	-DP	8.5 GHz / 17 Gbps

如需完整测试数据, 请浏览 www.samtec.com?QSS
或联系 sig@samtec.com



还提供

• 电路板间隔支架
(请参见 SO 系列)

QSS	每排位置数	01	电镀选项	D	A	其他选项
-----	-------	----	------	---	---	------

-025, -050, -075, -100
(每列总共 50 个位置)

-F

= 信号引脚和接地板上镀金膜, 焊尾镀雾锡

-L

= 信号引脚和接地板上镀 10μ" (0,25μm) 金, 焊尾镀雾锡

-C*

= 可选电镀
在触点区域的信号引脚上镀 150μ" (3,81μm) 镍, 之上镀最少 50μ" (1,27μm) 金, 在触点区域的接地板上镀 50μ" (1,27μm) 镍, 之上镀最少 10μ" (0,25μm) 金, 在所有焊尾上镀最少 50μ" (1,27μm) 镍, 之上镀雾锡。

-GP

= 导孔, 与 QTS-RA 配接

-K

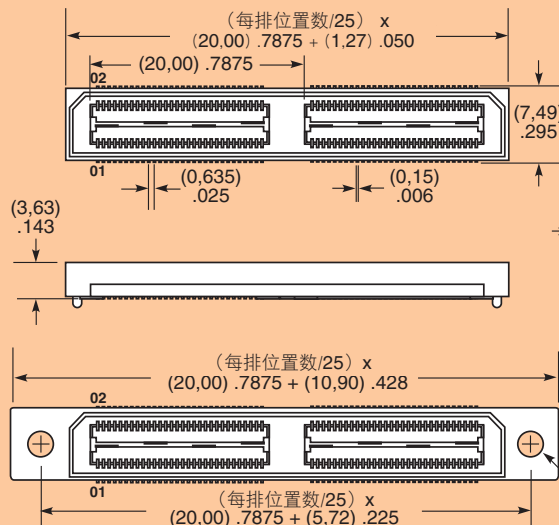
= (8,25mm) .325" 直径的聚酰亚胺膜取放垫

-TR

= 卷带封装 (-075 最大位置数)

特殊应用选项

- 11mm 和 16mm 堆叠高度 (小心: 有些自动放置/插入机械可能有元件高度限制。请参考机械技术规格。)
- 30μ" (0,76μm) 金
- 提供差分对和“可拆分” (在同一连接器中组合差分与单端列)。
- 每排 125 个位置
- 边缘封装
- 锁紧螺丝孔, 与 QTS-RA-LS2 配接的请致电 Samtec。



*注: -C 电镀通过 10 年 MFG 测试

注: 有些长度、式样和选项为非标准型, 不可退换。

因为技术的发展, 所有设计、技术规范和组件如有更改, 恕不另行通知。

WWW.SAMTEC.COM